eni versalis

RİBLENE® FF 33

Yüksek Molekül Ağırlıklı LDPE (Alçak Yoğunluklu Polietilen)

Şişirme film ekstrüzyonu için optimize edilmiş, kaydırıcı (slip) katkılı, yüksek performanslı polietilen çözümü.



- Güçlü eriyik dayanımı, mükemmel ekstrüzyon stabilitesi.

NotebookLM

Temel Karakteristikler

Malzeme DNA'sı

Erime Akış İndeksi (MFI)

0.8

g/10dk (190 °C / 2.16 kg)

Yoğunluk

0.923

g/cm³

Termal Dayanım

Erime Noktası:	**113 °C**
Vicat Yumuşama:	**95 °C**

Katkı Profili

Kaydırıcı (Slip Agent) İçerir

Düşük Sürtünme (COF: 0.11)

NotebookLM

Mekanik ve Optik Profil

Mekanik Güç

Kopma Uzaması (Yüksek Esneklik)



Elmendorf Yırtılma Direnci





Optik Kalite





Önerilen Film Kalınlığı: 30 - 120 µm

NotebookLM

En Uygun Uygulamalar



Shrink Film

Orta ve hafif yükler için shrink film üretimi.



Poşet ve Çantalar

Günlük kullanım için sağlam taşıma torbaları.



Laminasyon

Çok katmanlı yapılar için laminasyon filmleri.



Genel Ambalaj

Esnek paketleme ve polimer karışımları (blend).

NotebookLM

Neden RİBLENE® FF 33 Seçmelisiniz?



Şişirme film ekstrüzyonunda mükemmel bir **balon stabilitesi** (bubble stability) arıyorsanız.



Üretiminizde düşük sürtünme katsayısına (COF: 0.11) sahip, ambalaj hatlarında **kolay açılan ve kayan filmlere** ihtiyacınız varsa.



Ambalajınız **gıda ile temas edecekse** (Avrupa Birliği ve uluslararası gıda teması regülasyonlarına tam uyum).

NotebookLM

Hangi Durumlarda Alternatiflere Yönelmelisiniz?



Ağır Yük Shrink Uygulamaları

Bu spesifikasyon sadece “orta ve hafif yük” shrink filmleri için tasarlanmıştır. Ağır palet sargıları için uygun değildir.



Enjelsiyon Kalıplama Prosesleri

Malzemenin erime akış indeksi (0.8) düşüktür; tamamen ve sadece “şişirme film” (blown film) prosesi için optimize optimize edilmiştir.



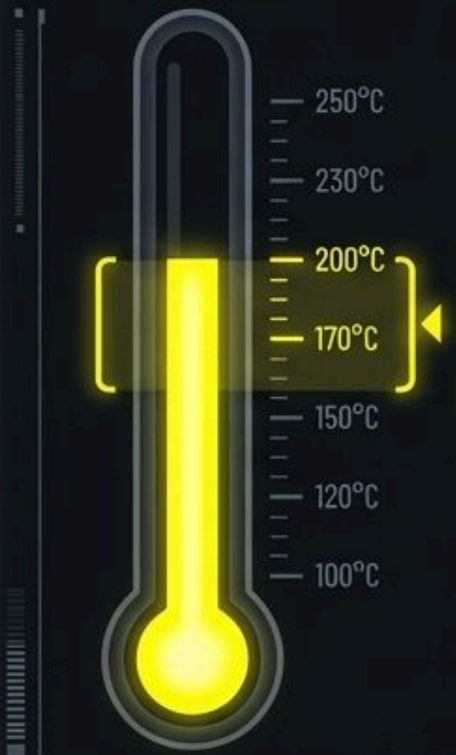
Yüksek Isı Beklentisi

95°C’de yumuşamaya (Vicat) başlar. Yüksek ısıl dayanım veya endüstriyel fırınlama gerektiren ambalajlar için uygun değildir.

NotebookLM

İşleme ve Depolama Parametreleri

Sıcaklık Kontrolü



Önerilen Eriyik Sıcaklığı:

170°C - 200°C

Depolama Kuralları



Sıcaklık < 50°C altında tutulmalıdır. Kuru ortamda, direkt güneş ışığından korunarak saklanmalıdır (Bozunma, renk ve koku değişimini önlemek için).

Toz Birikimine Dikkat!

Granül taşıma sistemlerinde statik elektrik ve toz birikmesi patlama riski yaratabilir. Sistemler topraklanmalı ve uygun filtreler kullanılmalıdır.

NotebookLM

KARAR ÖZETİ

RİBLENE® FF 33, şişirme film uygulamalarında aradığınız optimum esneklik, balon stabilitesi ve parlaklığı tek bir yüksek molekül ağırlıklı yapıda sunar.


Mükemmel Optik & Akış


Gıdaya Uygunluk


Stabil Proses

Teknik spesifikasyonların garantili değerleri ve sertifikasyonlar için bölgenizdeki Versalis satış ofisine başvurun.
(TDS Rev: Kasım 2014)

NotebookLM